

2010年6月吉日

インターンシップご担当者様

京セラ株式会社
人事企画部人材開発部
大西 実

<京セラサマーインターンシップ実施について（お願い）>

拝啓 向夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社の採用活動におきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社におきまして、学部3年生・修士1年生を対象とした、サマーインターンシップを実施する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

実際の就業体験を通じ、学生の皆様に将来のキャリアについて考えていただく機会となれば幸いに存じます。募集要項及び応募用紙をメールに添付しておりますので、貴学におきましても、広くご周知いただき、興味をお持ちの学生様がいらっしゃいましたら、是非、弊社サマーインターンシップをご紹介下さい。

なお、例年多数のご応募をいただく関係上、書類選考・面接選考を実施させていただいております。何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

末筆ながら、末永く変わらぬご厚情をお願い致しますと共に、貴学の益々のご発展を祈念申し上げます。

敬具

【連絡／お問い合わせ先】

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

京セラ株式会社 人事企画部 人材開発課 サマーインターンシップ担当： 岩田

TEL : 075-604-3510 (直通) FAX : 075-604-3512

E-mail : yousuke.iwata.yb@kyocera.jp

下記の職種にてインターンシップ実習へ参加ご希望の方を募集致します。

実習地・応募資格をよくお確かめの上、所定の「応募用紙」にてご応募下さい。

書類選考の上、結果につきましてはメールもしくは電話でご連絡致します。

【技術部門】

応募No	募集職種	実習地	期間	日数	寮	インターンシップ内容 (予定)	応募要件 (望ましい知識や資格など)	希望専攻	学年	
									大学 3年	修士 1年
A-1	ファインセラミック (製品設計) (製造技術)	八日市工場 (滋賀)	9月1日(水) ～9月7日(火)	5日間	有	サファイア基板の洗浄仕様試験 サファイア基板の加工仕様試験	脆性材料の加工、ラッピング、ホリッソク(GMP)、半導体洗浄技術の知識がある方歓迎	機械工学会系、 材料工学会系	○	○
A-2	ファインセラミック (開発・評価)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	有	機能性セラミック材料のデータ収集と 解析評価	セラミックスに興味のある方歓迎	材料工学会系、 物理化学系	○	○
A-3	ファインセラミック (開発・評価)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	有	非酸化物セラミックス焼結体の評価	セラミックスに興味のある方歓迎	材料工学会系、 物理化学系、 物質工学会系	○	○
A-4	切削工具 (製造技術)	川内工場 (鹿児島)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	—	切削工具材料工程の生産性改善	粉末成型/焼結材料に興味のある 方歓迎	材料系	○	○
A-5	切削工具 (製造技術)	川内工場 (鹿児島)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	—	切削工具研削加工工程の生産 性改善	研削加工に興味のある方歓迎	機械系	○	○
A-6	切削工具 (開発・評価)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	—	硬質コーティングによる切削工具加 工性向上	材料知識、または 薄膜技術知識のある方歓迎	物質系、機械 系、材料工学 系	○	○
A-7	切削工具 (評価・解析)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	—	切削工具における材料特性と切 削性能の関連性に関する実習	機械加工、金属加工、セラミック、粉末 冶金等に興味のある方歓迎	物質系、機械 系、材料工学 系	○	○
A-8	切削工具 (開発・評価)	八日市工場 (滋賀)	9月1日(水) ～9月7日(火)	5日間	有	高エネルギー加工エドミルの切削評価・ 分析	切削工具や、切削加工に興味のある 方。設計、開発に興味のある方	機械系	○	○
A-9	応用商品 (開発・評価)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	—	セラミックキャッチングスの新商品評価 実習	セラミック包丁・電動用商品など応用 商品・完成品に興味ある方(IE・経 営系以外なら専攻は問いません)	特になし	◎	○
A-10	応用商品 (開発・評価)	伏見事業所 (京都)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	有	セラミックキャッチングスの新商品評価 実習	セラミック包丁・電動用商品など応用 商品・完成品に興味ある方(IE・経 営系以外なら専攻は問いません)	特になし	◎	○
A-11	通信機器 (ユーザーインターフェイス デザイン)	横浜事業所 (神奈川)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	—	User-Centered Designを用いた 携帯電話のユーザーインターフェイス設 計および情報デザイン	デザイン手法、評価手法、プロトタイプ デザインの基礎知識がある方	特になし	—	○
A-12	通信機器 (製品設計)	横浜事業所	9月1日(水) ～9月7日(火)	5日間	—	携帯電話のCADデータ作成から 簡易モック製作までの開発プロセス 体験	携帯電話開発に興味があり、もの 作りを体験してみたい方歓迎	機械・精密機 械系	○	○
A-13	通信機器 (開発・評価)	横浜事業所 (神奈川)	9月1日(水) ～9月7日(火)	5日間	—	フィルタなどの高周波受動部品の 測定と考察	携帯電話の無線通信に興味がある 方。高周波の知識(ミスチャート、ネッ ワークアナライザなど)がある方歓迎	電子・情報通 信系	○	○
A-14	通信機器 (開発・評価)	横浜事業所 (神奈川)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	—	PHS端末の電気回路評価	電子回路の基礎知識がある方、ま たはPHS電話、回路設計に興味を 持っている方	電気電子系	○	○
A-15	ソーラー発電システム (評価・解析)	伊勢工場 (三重)	8月25日(水) ～8月31日(火)	5日間	—	太陽電池モジュールの評価	太陽電池に関心がある方	電気系、化学 系	○	○
A-16	生産技術開発 (評価・解析)	玉造事業所 (大阪)	8月25日(水) ～8月31日(火)	5日間	有	モーター駆動ステーションの動作挙動解 析	機械に興味のある方、Excel(主に グラフ化)の基礎知識がある方歓迎	機械系、電気 系	○	○
A-17	自動車部品 (評価・解析)	国分工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月24日(火)	5日間	有	車載カメラの評価とそのデータ収 集・解析	電子回路・機械・光学・カメラに興味 のある方歓迎	特になし	○	○
A-18	自動車部品 (開発・評価)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	有	①開発品(ヒーター)の工程データ収 集、解析、工程能力の算出 ②開発品の特性に影響する不 良モードの調査	セラミック部品の商品開発に興味があ る方	化学系、材料 系	○	○
A-19	自動車部品 (開発・評価)	用賀事業所 (東京)	8月19日(木) ～8月24日(火)	5日間	—	市場品および開発中の車載カメラ モジュールの評価、比較	自動車部品、カメラに興味のある方	特になし	○	○
A-20	半導体部品 (製造技術) (生産技術)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	—	セラミックパッケージの製法プロセス実 習	セラミックスに興味を持っている方	電気系、機械 系、材料系、 化学系	○	○
A-21	半導体部品 (開発・評価)	国分工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月24日(火)	5日間	有	セラミック基板への配線加工実習	フットエッチングに興味のある方歓迎	特になし	○	○
A-22	半導体部品 (製造技術)	国分工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	有	セラミック生加工工程におけるデータ の収集と解析	セラミックの一般基礎知識または、興 味のある方歓迎	特になし	○	○
A-23	半導体部品 (シミュレーション)	蒲生工場 (滋賀)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	有	シミュレーションソフトを使用した、光通 信、無線通信用パッケージの設計	通信分野に興味を持っている方	特になし	○	○
A-24	半導体部品 (シミュレーション)	蒲生工場 (滋賀)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	有	照明解析ソフトを用いたLED照明 器具の光学設計、及び製品の測 定・評価	固体照明に興味を持っている方	特になし	○	○
A-25	半導体部品 (開発・評価)	国分工場 (鹿児島)	9月1日(水) ～9月7日(火)	5日間	有	外観検査における画像検査機で (評価データ収集とデータ解析によ る検証)	画像処理に興味があり、実機に触 れて操作したい方歓迎	電気電子系、 機械工学会系	○	○
A-26	半導体部品 (評価・解析)	国分工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	有	セラミック基板の設計検証 (評価データ収集とデータ解析によ る検証)	統計的計算/手法の知識のある 方、回路図、製品図面を読む知識 のある方歓迎	特になし	○	○
A-27	半導体部品 (製造技術)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(木) ～8月31日(火)	10日間	—	セラミックパッケージの寸法精度改善	パソコン操作の基礎知識(excel等)、 データ解析手法等の知識がある方 歓迎	機械系	◎	○
A-28	半導体部品 (製造技術) (開発・評価)	川内工場 (鹿児島)	8月25日(水) ～9月7日(火)	10日間	—	LED用セラミックパッケージの開発に 関する実習	セラミック材料に対する知識を有する か、興味のある方	化学系	◎	○

※横浜事業所、用賀事業所、川内工場、伊勢工場は、寮の手配が困難なため、自宅から通勤可能な方が対象となります。
※募集は各職種1名ないしは2名です。

※ご希望の応募No.、職種、実習地をご記入下さい。(募集職種リスト参照)

第1希望	応募No.		応募職種名		実習地	
第2希望	応募No.		応募職種名		実習地	

学生時代に強い思いを持って取組んだ、または取組んでいること

京セラのインターンシップへ参加する理由

応募職種の選択理由と裏づけとなる保有知識や技術

(2 / 2 枚目)

【記入上の注意】

- ・ 字数制限はありません。自由にお書き下さい。枠をオーバーする場合や補足資料のある場合は別紙にて同封下さい。
- ・ ペンまたはボールペンにて記入して下さい。(鉛筆書き不可)
- ・ 応募用紙は全2枚です。

【アンケートにご協力下さい】

- ・ 当社のインターンシップに参加しようと思ったきっかけを教えてください。(選択肢に○をつけてください。)

- ①就職サイト (どのサイトですか?)
- ②インターンシップイベント (どのイベントですか?)
- ③当社ホームページ
- ④告知ポスターを見て (どこで見ましたか?)
- ⑤その他 ()

京セラ サマーインターンシップ

「将来のキャリアや、仕事の適性について考えたい！」という皆さんのご要望にお応えします。
 京セラのダイナミックな事業活動や仕事に取り組む熱い姿勢を体感してください。
 チャレンジ精神溢れる皆さんからのご応募をお待ちしております。

募集職種	技術部門(開発/設計評価/製造技術など)
実習地	東京/神奈川/三重/大阪/京都/滋賀/鹿児島
期間・ 実習時間	8月中旬～9月中旬(実習日数:5日間コース または 10日間コース) 9:30～17:30または8:45～16:45 ※実習テーマにより開始日・期間・実習時間は異なります。
対 象	大学3年生または修士1年生の方(理工系専攻の方)
待 遇	交通費：自宅または宿泊施設から職場までの通勤実費を支給。 食事代：出勤日のみ支給。 宿泊施設：自宅からの通勤が困難な方には、宿泊施設を提供いたします(一部の拠点除く)。

▶▶ インターンシップの詳細は弊社HPでご確認いただけます。

URL : www.kyocera.co.jp/recruit/intern/

【応募方法】 HPより「サマーインターンシップ応募用紙」をダウンロードし、下記送付先まで郵送して下さい。

※6月30日(水)必着

【送付先】 京セラ株式会社 人事企画部人材開発課 サマーインターンシップ担当
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
 (お問い合わせ) 直通TEL:075-604-3510 / E-Mail: saiyou@kyocera.jp